

SMT 256C 焊点封装材料 产品数据表

提升焊点可靠性
消除焊点开裂
无需底部填充

简介

SMT 256C 焊点封装胶旨在提高焊点可靠性，並消除 CSP、BGA、倒装晶片和 PoP(封装叠层封装) 等封装类型的焊点开裂问题，尤其适用于无铅焊接应用。在回流焊过程中，SMT 256C 可去除金属氧化物，使焊点得以形成；同时，三维聚合物网络开始形成，並封装单一焊点，从而增强焊点强度，消除底部填充的一些缺点(例如高于玻璃化转变温度 (Tg) 的高热膨胀系数、制程控制困难等)。與使用助焊剂或焊膏相比，SMT 256C 可显著提高焊点的可靠性，例如热循环和跌落性能。此聚合物网络可以使用丁酮 (MEK) 或加热来去除。

物理特性

产品名称	SMT 256C 焊点封装胶黏剂
外观	黑色液体
未固化材料性能	
项目	数值
比重 (ASTM D1475-60)	1.05
粘度 (Brookfield, 0.5 rpm)	8,000-10,000 cp
定量卤化物含量	0%
提取离子(MIL-STD-883E)	
Na+	<5ppm
K+	<5ppm
F-	<5ppm
Cl-	<10ppm

表面绝缘电阻 (J-STD-004)	通过 (Pass)
--------------------	-----------

應用

SMT 256C 可透過浸塗、點膠、印刷(模板或網版印刷)或引腳轉移等製程進行塗覆。SMT 256C 用量過少會導致焊點空洞或焊點開路;用量過多則會導致焊錫橋接或焊錫溢出。為了獲得高效益和最佳可靠性,必須優化 SMT 256C 的塗覆製程參數。

回流焊接和固化

SMT 256C 與目前的 SMT 組裝流程以及所有類型的焊盤表面處理(例如 Ni/Au、浸銀、OSP)完全相容。它可在空氣或氮氣環境下,用於對流、傳導、紅外線或氣相焊接系統。從環境溫度升至峰值溫度的時間應為 4 至 5 分鐘,峰值溫度範圍為 230°C 至 260°C。

儲存和保存期限

如果材料保存在密封的原包裝容器中,溫度保持在 -20 °C 或以下,則保存期限為 6 個月。超過此期限儲存可能會導致黏度升高。請防止受潮、蒸發和外來物污染。蒸發和污染會嚴重影響這些產品的加工性能。

安全信息

SMT 256C 是一種安全無毒的材料。但是,建議在處理該材料時遵循一般的衛生操作規範。更多詳細信息,請參閱我們的安全資料表 (SDS)。

包裝規格

SMT 256C 系列浸漬膠提供 5cc、10 cc、30cc。其他包裝可依客戶需求提供。如需訂購信息,請聯繫 YINCAE 公司。